

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流
活动参与人员	嘉实基金、鹏华基金、国海证券、国金证券、中邮证券、兴全基金、千合资本、中盛晨嘉、国诚投资、宽兮投资、华创证券、和聚投资、灏俊投资、平安证券、德邦证券、国海富兰克林、易方达、宝盈基金、方正证券、摩根资产、兴证全球基金、广发证券共 22 家机构机构。
时间	2023 年 12 月 5 日-2023 年 12 月 29 日
地点	公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概述 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性

的提升。

二、问答环节

1、公司今年的人员增速非常快，研发投入是否对比往年有大幅增长？

公司作为技术驱动型的高科技企业，深知创新研发是企业可持续发展的动力和灵魂。随着公司业务范围的扩大以及产品与技术的深入拓展研发，为给客户提供更优质的产品、技术和服 务，支持公司进一步拓展可制造性设计（DFM）、可测试性设计（DFT）等 EDA 软件和多品类电性测试设备的研发，公司今年整体保持较快的人员增速。截至 2023 年 9 月末，公司人员总数为 471 人，相比去年年底人员增加 48.11%，相应地，公司的研发成本也会增长，相信通过公司在良率提升领域持续的深耕铸造，能够利用创新开发的先进技术和产品进一步巩固公司的竞争壁垒，提升企业的核心价值和市场影响力，为公司后期的业务发展拓宽赛道、积累势能，实现公司长远、稳健的可持续发展。

2、公司除在可制造性设计和可测试行设计领域的拓展外，是否还有其他软件产品的中长期布局？

广立微在集成电路良率提升领域深耕近 20 年，在与诸多集成电路企业合作的过程中意识到半导体数据的重要性，已经开始着力布局研发集成电路数据分析系统软件。公司利用在软件开发领域的技术经验结合对集成电路数据的深度分析能力，已经开发出一套比较完整的离线大数据系统，包含良率管理分析、缺陷管理分析等产品，实现半导体产业内各类数据的整合分析与管理。

目前公司正在利用人工智能及机器学习技术着力开发在线监控分析的基础模块和软件，并不断丰富公司的软件产品业务线。在线监控软件需要解决海量数据的实时获取分析、及时

并反馈正确结果以阻止损失或修正误差、与客户自有控制系统深度融合等技术难题，因此需要投入较大规模研发人员进行开发和产品成熟度打磨，才能输出高可靠性、高质量的产品与技术。

3、公开信息显示公司的晶圆级可靠性测试机已经开始向客户端供应，请公司介绍一下该设备的作用？

晶圆级可靠性 (WLR) 测试是半导体工业中非常重要的一个环节，用于评估半导体器件在实际应用中的可靠性。特别随着新能源汽车等新兴应用场景的涌现，市场对芯片产品的可靠性和性能需求大幅度提升，也越来越重视在芯片制造阶段的晶圆级可靠性。这些特殊应用场景的使用环境复杂多变，芯片在整个生命周期内会经历不同的温度、湿度环境，以及集成电路本身的电磁干扰，所以 WLR 测试往往是模拟一些应用环境中极端的情况，针对芯片元器件在特定状态下，经过一定时间的加速测试后，检查元器件是否能保持其电性规格高一致性的能力。

公司在电性测试领域拥有十多年的研发经验，今年年中推出的 WLR 测试设备具备稳定的硬件系统，且结合公司定制化的软件系统实现软硬协同，能够满足芯片各种可靠性测试的需求，包含：高电压、高电流、长时间以及高低温量测等，通过模拟工作环境进行全面检测，保障在研发、设计、制造中芯片的高质量和可靠性。

4、请公司简要介绍今年在对外投资方面的情况。

上市公司通过投资并购实现业务扩展是一种非常重要的途径，EDA 行业又具有产品链长、工具品类繁多的特点，因此更需要投资并购加快企业发展。公司 2023 年的主要投资方式包括：

- 通过与专业的投资机构共同设立了两家产业投资基金，重点投向半导体行业具备核心技术和竞争力的企业；

	<ul style="list-style-type: none"> • 公司对外投资并设立境内外全资子公司，以利用区域优势实现业务拓展，并服务好更多的客户，具体包括投资设立深圳子公司和新加坡子公司； • 投资与公司良率提升业务具有协同性的企业，加快公司产品线拓展，完善公司的良率提升总体解决方案，如投资上海亿瑞芯科技有限公司拓展 DFT 业务与产品研发； • 近期，公司联合浙江省内部分 EDA 企业共同投资设立半导体签核中心，拟以签核数据为关键抓手，以设计签核和制造签核为重点环节，打造高质量的签核 EDA 解决方案。这也是公司通过资源整合模式探索的一种对外投资方式。 <p>5、如何评价当下的行业环境及对未来的预期？</p> <p>2023 年，受到外部贸易环境和终端需求两方面的影响，半导体行业整体发展和资本投入节奏放缓，短期内会对行业内大多数公司造成一定影响。但从半导体产业发展的角度，持续推进攻关研发、实现高质量替代的步伐不会停止，且随着车规电子、人工智能等新兴领域的快速发展，市场机会巨大。公司长期专注于芯片良率提升和电性测试快速监控领域，随着公司 EDA 工具链、设备产品的进一步丰富以及良率解决方案的进一步完善，有信心也有机会持续保持经营业绩的稳定增长。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2023 年 12 月 29 日